

苏州国芯科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案

为践行以“投资者为本”的发展理念，提高上市公司质量，树立良好市场形象，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，基于对公司未来增长潜力与内在价值所抱持的信心，苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国芯科技”）于 2025 年 4 月 29 日发布了《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》（以下简称“行动方案”），公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作。公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》（以下简称“本行动方案”），现将 2025 年的主要工作成果以及 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案报告如下：

一、聚焦主营业务，积极开展新产品和新技术的研发、应用

公司是一家聚焦于国产自主可控嵌入式 CPU 技术研发和产业化应用的芯片设计公司，公司致力于服务安全自主可控的国家战略，为国家重大需求和市场需求领域客户提供 IP 授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品，主要产品应用于汽车电子和工业控制、信创和信息安全、人工智能和先进计算三大关键领域。持续聚焦汽车电子、信创与信息安全、人工智能等业务，积极研发和推广应用新产品，是公司持续发展的重要驱动力，从而进一步巩固公司在汽车电子、量子安全、AI 领域的市场竞争地位。

（一）汽车电子芯片新产品持续增加，高端芯片应用与出货加快

公司汽车电子芯片业务坚持“MCU+”策略，即以 MCU 为核心，搭配混合信号（含驱动类）、通信接口芯片和传感器芯片，形成整体解决方案满足客户的“套片”方案式需求。这一策略有效提升了客户合作深度与黏性，使公司能够在与国外厂商的竞争中形成差异化优势。目前，公司已构建起覆盖“基础控制—高端智能”“MCU-数模混合-DSP”的较为完整的产品矩阵，12 条车规级芯片产品

线逐步向高端演进，为解决我国汽车行业“缺芯”问题作出持续努力。

2025年，在汽车电子领域，公司成功研发了48V安全气囊点火芯片CCL1800B、新一代汽车电子BLDC（无刷直流）电机驱动控制芯片CBC2100B等新产品，实现了DSP芯片的量产，高端域控MCU芯片CCRC4XXX系列（原CCFC3009PT）按计划进入流片阶段，该芯片融合神经网络计算的AI协处理单元，集成符合国际标准（NIST FIPS203、FIPS204）的抗量子密码算法，构建面向量子计算时代的车载安全防护体系。公司是业内率先布局车载抗量子计算防护方案的芯片设计企业之一，该芯片总体性能对标英飞凌TC4DX系列芯片，部分指标实现超越，具备国际先进水平。2025年4月，CCD5001 DSP芯片荣获中国汽车芯片产业创新战略联盟颁发的“2025年度创新力汽车芯片”奖项。2025年，在算法与生态合作层面，公司已与Dirac等国内外多家行业头部企业达成合作，携手打造完整闭环的DSP算法生态，公司还与阿尔派等国际知名汽车音频系统供应商开展合作，共同开发面向全球市场的高性能车载音频解决方案。作为国内首颗获得TÜV北德ISO 26262 ASIL-D功能安全产品认证的安全气囊点火驱动芯片，已在多家整车厂实现装车应用和批量出货。

2025年，公司芯片在线控底盘领域实现批量出货装车，同时与英创汇智、辰致、同驭、恒隆、千顾、孔辉等国内领先的Tier1模组厂商保持紧密合作，并已获得国际Tier1模组厂商的定点开发，该领域产品属于公司重点布局、技术壁垒较高的中高端汽车芯片序列。线控底盘是智能驾驶执行层的核心组成部分，包括线控制动、线控转向、线控悬架等子系统，对芯片的功能安全等级和可靠性要求极高。公司线控底盘芯片实现与国际头部Tier1的定点合作，表明公司产品在性能、可靠性和功能安全方面已得到更加广泛认可，为后续拓展更多国际客户奠定了基础。

同时，公司在车身和网关控制芯片、车联网安全芯片、安全气囊控制器芯片方面继续放量增长。动力总成控制芯片、域控制芯片、新能源电池管理芯片等均实现上车量产，定点数量持续增加，以上领域产品是汽车的核心部件，对精度、可靠性和功能安全等级要求极高，以上领域高端芯片产品实现批量供货，产品性能和稳定性获得客户认可，成为公司汽车电子业务的重要增长点之一。

2025年，公司汽车电子芯片业务进展明显，全年出货量超过1300万颗，截

至 2025 年末累计出货量突破 2500 万颗，自主汽车电子芯片业务收入达 12,650.20 万元，同比增长 82.32%。公司在汽车域控制芯片、辅助驾驶控制芯片、主动降噪专用 DSP 芯片、动力总成控制芯片、新能源电池管理芯片、线控底盘芯片、车身和网关控制芯片、车联网安全芯片、仪表及小节点控制芯片、安全气囊芯片、数模混合信号类芯片和智能传感芯片等 12 条产品线上实现系列化布局，不断拓展汽车电子芯片产品的宽度和深度。包括 CCFC3007PT/BC、CCFC3008PT/PC、CCFC3010PT、CCFC3012PT 和 CCD5001 在内的高端车规 MCU 和 DSP 芯片系列均已实现市场销售应用。

2026 年，公司将推动汽车电子芯片销售规模实现进一步提升，深化与比亚迪、奇瑞、吉利、长安、一汽、上汽集团、东风等头部主机厂客户的合作，进一步拓展国际零部件标杆客户，努力实现中高端汽车电子芯片更大规模的销售。积极参与行业展会，持续策划“走进主机厂”系列活动，进一步提高品牌知名度和美誉度。

2026 年，公司将持续推进 CCL1800B 48V 安全气囊点火芯片的市场拓展，配合 48V 系统客户需求，完善 48V 混合信号芯片设计平台。基于 CCD5001/CCD4001/CCD3001 系列 DSP 芯片，持续完善“开放算法库+敏捷开发”的 DSP 算法生态，拓展更多座舱音频应用场景，深化与歌尔声学、DSPIC、ARAMYS 及赛朗声学等国际国内合作伙伴的战略协同，推动主动降噪、高阶音效等方案在更多车型量产，联合合作伙伴推出更多 DSP 应用解决方案，覆盖主动降噪、车载高阶音效、语音识别等多个应用场景，持续构建完整的 DSP 开发生态，降低客户开发门槛，加速产品导入。加快 CCRC4XXX 系列(原 CCFC3009PT) 高端域控 MCU 芯片的测试验证与头部客户导入工作，力争实现装车突破。同时，公司将完善安全气囊芯片“主控 MCU+点火驱动芯片+加速度传感器芯片”全栈国产化套片方案，深化与客户的战略合作，持续扩大市场份额。

2026 年，公司将重点推进线控底盘芯片的量产交付，实现销售规模的扩大，通过“MCU+电磁阀驱动”套片方案的拓展，增强公司在线控制动领域的竞争力。公司将进一步拓展套片方案的应用领域，在动力总成、新能源电池管理、车身控制等领域推出更多“MCU+”套片方案，为客户提供一站式解决方案，提升客户合作深度与黏性。

（二）云安全和量子安全领航创新，自主可控生生不息

2025年，公司在量子安全领域推出了AHC001抗量子芯片、CUni360SQ-ZX抗量子金融POS芯片、CCUPHPQ01抗量子密码卡等系列化产品，完成了年度研发目标。

2025年，公司信创与信息安全业务收入达19,539.36万元，同比增长39.38%。公司在云安全芯片、量子安全芯片、抗量子密码芯片、RAID存储控制芯片等领域取得多项重要突破。

（1）云安全芯片领域：CCP917T 极高性能云安全芯片

2025年4月，公司基于RISC-V架构多核CPU自主研发的超高性能云安全芯片CCP917T内部测试成功。该芯片是公司目前性能最强劲的云安全产品，基于自主RISC-V架构的CRV7高性能四核64bit CPU核设计，CPU主频可达1.4GHz，集成了神经网络处理单元（NPU）。芯片内嵌高性能安全算法引擎（SEC），支持国密标准算法和国际通用算法，其中SM2签名效率高达100万次/秒，对称算法性能达到80Gbps。该芯片支持PCIE4.0接口，支持SR-IOV硬件虚拟化技术，最多可支持256路虚拟机，并支持芯片级联扩展。目前，该芯片已完成内部测试，正在客户应用中，并于2025年底通过商用密码检测认证中心的商用密码检测认证，获得商用密码产品二级认证。公司基于超高性能云安全芯片CCP917T已研发PCI-E密码卡产品CCUPH2H01和CCUPH3H01。这两款产品均遵循国家密码管理局关于PCI密码卡的相关技术规范，支持PCI-E 4.0 x8/x16模式，支持SM1、SM2、SM3、SM4、SM9等国密算法，支持硬件虚拟化，能够为各类安全平台提供多线程、多进程和多卡并行处理的高速密码运算服务。该系列密码卡可广泛应用于云服务器密码机、云服务密码平台、安全接入网关、负载均衡网关、下一代防火墙（NGFW）等安全设备。CCUPH2H01和CCUPH3H01已在多领域实现应用导入，送样头部客户10余家，应用领域包括网络安全、云密码服务、可信计算等。

2026年，依托公司在云安全领域已有的优质客户资源如海康、大华、深信服、安恒信息、信安世纪、格尔软件、国家电网、中安网脉、吉大正元和中星电子等，超高性能云安全芯片CCP917T将重点推进客户应用落地，拓展在人工智能、云计算安全、网络安全和运营商核心网等高端应用场景的市场份额，推动云

安全芯片业务向高端化、高利润率方向发展。依托其 100 万次/秒的 SM2 签名性能和 80Gbps 的对称算法性能，重点突破 AI 服务器、大型数据中心、5G 核心网等关键客户。除此之外，国芯科技云安全产品线将持续紧跟技术发展趋势，在信息安全技术领域不断推陈出新、勇于向网络安全和密码服务应用的更快、更高、更安全的巅峰攀登。

(2) 量子安全芯片领域

2025 年，公司结合合作伙伴的量子随机源，设计开发了 CCM3310SQ-T、A5Q、CCP907TQ 等量子安全芯片及系列化量子安全模组产品，将传统安全加密功能与量子随机数相结合，具备更高安全性。系列化模组产品涵盖量子安全 U 盾、多种形态的量子密码卡等，满足不同性能等级的安全需求。公司的多款量子安全产品已被中电信量子、问天量子、合肥硅臻等量子领域的重要企业采用并实现销售，成功应用于电力、通信等关键领域。公司与问天量子成立的“量子芯片联合实验室”协同攻关，成功推出的量子安全芯片 CCM3310SQ-T 已实现小批量实际供货。

2026 年，公司将持续推进量子安全芯片和模组的研发与应用，依托与问天量子、合肥硅臻等合作伙伴的联合实验室，深化量子安全技术更多关键领域的产业化落地。

(3) 抗量子密码领域

在抗量子密码领域，针对 NIST 公布的基于格原理、哈希原理和编码原理三种类型的五个抗量子密码算法，国芯科技已开展从抗量子密码算法理论研究、算法硬件架构设计、算法软硬件实现、算法侧信道安全等多层次多维度的深入研究。目前已完成了 NIST FIPS 203 (ML-KEM)、FIPS 204 (ML-DSA)、FIPS 205 (SLH-DSA) 三个算法模块的硬件设计，其中 ML-KEM 和 ML-DSA 是基于格原理的抗量子密码算法，SLH-DSA 是基于哈希原理的抗量子密码算法。同时还提交了多个抗量子密码算法硬件设计及侧信道防护相关的专利申请。ML-KEM/ML-DSA/SLH-DSA 三个抗量子密码算法 IP 已成功应用在公司抗量子密码产品中。正在进行 NIST FIPS 206 (FN-DSA) 的算法硬件设计以及 NIST HQC 算法的理论研究及算法硬件架构设计，其中 FN-DSA 是基于格原理的抗量子密码算法，HQC 是基于编码原理的抗量子密码算法。后续还将基于现有的格

原理的抗量子密码算法引擎添加更多的算子指令，从而能支持更多的基于格原理的抗量子密码算法，同时还将针对多变量原理和同源原理进行算法理论的研究和软硬件实现等工作。

公司已经与多家抗量子领域的产学研用单位展开深度合作，包括：南方电网、中科院信工所、复旦大学、西交利物浦、中移互联网、问天量子、信安世纪、北京 CA、得安信息、中云信安、信大壹密、泓格后量子、之江数安量子、国腾量子等，合作成果已开始应用于金融、能源、通信等关键领域。

①抗量子金融 POS 机芯片 CUni360SQ-ZX

2025 年 12 月，公司与中云信安合作研发的抗量子密码金融 POS 机芯片 CUni360SQ-ZX 已通过银行卡检测中心依据国际 PCI PTS 7.0 规范开展的芯片安全评估，系国内首个通过该项认证的抗量子金融支付芯片。

2026 年，公司将加快 CUni360SQ-ZX 抗量子密码金融 POS 机芯片的方案开发与客户导入工作，争取实现规模化应用。将重点推进在金融支付领域的信息安全升级应用，依托公司累计超 1 亿颗的金融 POS 芯片出货基础，加快新一代抗量子产品的市场渗透。联合主要 POS 终端厂商，持续推动基于 CUni360SQ-ZX 的新一代抗量子 POS 终端解决方案。

②抗量子密码芯片 AHC001

2025 年，公司与参股公司信大壹密合作研发的抗量子密码芯片 AHC001，基于国产 28nm 工艺完成投片并内测成功。该芯片可以同时支持抗量子密码算法和传统密码算法应用，具备低功耗、算法可重构、高安全性以及高扩展性特点，适用于对安全要求较高的各种端和边缘侧设备场合。目前，该款抗量子芯片产品正在国家重大需求领域客户进行验证应用。

2026 年，公司将积极推动 AHC001 抗量子密码芯片在国家重大需求领域客户的验证工作，稳步推进抗量子密码芯片联合开发项目的后续工作。鉴于国家重大需求领域的验证周期较长，公司将积极配合客户推进相关验证工作，确保产品满足安全性、稳定性及可靠性要求，建立专项技术团队，快速响应客户需求。

③抗量子密码卡 CCUPHPQ01

2025 年，公司成功研制了抗量子密码卡 CCUPHPQ01，该产品是基于国芯科技 CCP1080T 安全芯片设计，支持 SM2、SM3、SM4 等国密算法，同时支持

Kyber、Dilithium、Sphincs+等后量子算法，可广泛应用于签名/验证服务器、安全网关/防火墙等高安全要求的信息安全设备中。

2026年，公司将加快CCUPHPQ01抗量子密码卡在签名/验证服务器、安全网关/防火墙、安全数据传输、可信计算等场景的应用推广，满足关键基础设施的抗量子密码迁移需求。联合信息安全方案商，持续推动基于CCUPHPQ01的抗量子密码卡解决方案在政务、金融、能源等关键行业的应用。

(4) RAID 存储控制芯片领域

2025年，公司致力于RAID控制芯片的国产化替代，在市场上积极推进CCRD3316/CCUSR8116、CCRD3304/CCUSR6104等RAID控制芯片及阵列卡产品的应用，旨在实现对国际厂商主流产品的替代，公司RAID芯片和模组在国内处于先进水平。

2026年，公司将进一步加快RAID控制芯片及阵列卡产品的市场拓展，推进在多家客户的应用落地，实现对国际厂商主流产品的国产化替代。积极推进RAID芯片在信创服务器厂商的导入，推动在政府、金融、能源等关键行业的应用。

(5) 重点项目参与情况

2025年，公司与西交利物浦大学后量子迁移交叉实验室合作承担的2025年度苏州市关键核心攻关项目——“基于RISC-V架构的高性能抗量子密码芯片关键技术研发”于2025年12月正式启动实施，正在有序推进中。牵头承担省市级重大科技项目，是公司在抗量子密码领域技术领先性与产业带动能力获得政府主管部门认可的重要佐证。

公司参与的“国际金融银行业典型交易业务抗量子迁移的关键技术验证与应用示范”项目于2026年2月正式启动实施，这是国家重点研发计划项目，国芯科技主要负责研究抗量子密码芯片多算法融合及安全防护的实现机制，满足金融行业抗量子密码应用迁移的需求。公司将做好该国家重点研发计划项目的研发工作，持续推进与西交利物浦大学合作承担的苏州市关键核心攻关项目。依托国家级重点研发项目的技术成果，加快抗量子密码技术的产业化应用，推动相关产品在金融、政务等关键领域的示范应用，为大规模市场推广奠定基础。

(三) 智能开启想象，边缘/端侧 AI 未来可期

2025 年，公司端侧 AI 芯片开始在市场上实现规模化销售。

(1) 端侧 AI 芯片 CCR4001S

2025 年，公司推出的 AI MCU 芯片 CCR4001S 以“RISC-V CPU + AI NPU”的双核方式，基于自主 RISC-V 架构 CPU CRV4H 内核研发，带有 AI NPU，集成了一个 0.3 Tops@INT8 算力的神经网络处理单元（NPU），专门用于加速 AI 任务。2025 年 9 月，在 2025 中国国际消费电子博览会上，展出了公司 CCR4001S AI MCU 芯片在新一代商用空调中的落地应用，并已实现了批量出货；工业安全领域，在电力拉弧检测等场景已落地验证；智能传感领域，推出基于 CCR4001S 芯片的多种 AI 传感器模组，助力客户加速量产导入。

2026 年，公司将加快 CCR4001S 芯片在智能家电、智能工控、智能传感等领域的市场拓展，重点推广拉弧检测、电机控制等刚需与政策支持领域。基于其在商用空调领域目前已超 10 万颗的出货基础，拓展至更多家电品类和工业场景，包括智能家居、工业自动化、智慧城市等，持续推进在智能家电、智能工控、智能传感等应用场景的客户导入。

(2) NPU 技术研发

2025 年，公司与香港应科院持续深化合作，完成 CNN100 NPU、CNN200 NPU 研发。自 2023 年 10 月国芯科技与香港应科院签署合作备忘录及人工智能芯片技术项目研发支持协议以来，公司持续投入研发经费和 NPU 研发团队，与香港应科院联合开发面向边缘侧 AI 应用的神经网络处理器（NPU）。2024 年 5 月，国芯科技与香港应科院联合成立新型 AI 芯片联合研究实验室，进一步助力 RISC-V CPU 和 NPU 技术的融合发展。CNN20/CNN100 单核算力可达 1Tops@INT8，适用于低功耗要求的 AI MCU 芯片；CNN200 系列单核算力可达 10Tops@INT8，适用于各种边缘计算 AI SoC 芯片。同时，公司正在与参股公司龙擎空天合作面向 AIPC 应用研发 CNN300 系列 NPU IP 核，单核性能可达 8TOPS，可配合应用进行 Deepseek、Qwen、LLaMa 等常用大模型卸载。

2026 年，公司将围绕 CNN100、CNN200、CNN300 持续开展 NPU 软件生态建设，研发全面、易用的 AI 软件包（包括各种工具、SDK 软件、编译器、调试器等），推动 NPU 技术落地和 AI 应用创新。将持续完善 NPU 软件开发平台，包括模型转换工具、量化工具、编译器、运行时库等，支持 TensorFlow、PyTorch、

ONNX 等主流 AI 框架，构建开放、易用的 AI 开发环境。同时，公司将持续投入 AI 神经网络处理器 NPU 技术的研发，围绕 CNN20、CNN100、CNN200 系列化 NPU IP 核开展技术迭代与优化。面向 AIPC 应用，与龙擎空天深化合作，实现 CNN300 系列 NPU IP 核的优化设计，并完成基于 CNN300 NPU 的边缘侧 PC AI GPNPU 芯片的开发和流片工作。

（四）产业生态建设取得重要进展

2025 年 8 月 22 日，在江苏省工信厅指导下，由国芯科技、中国电子科技集团第 58 研究所、东南大学集成电路学院、南京大学集成电路学院等 50 多家单位共同发起的江苏省 RISC-V 产业联盟在苏州正式揭牌成立，国芯科技当选为联盟首任理事长单位。2025 年 11 月，公司牵头筹建“开源 RISC-V 汽车电子芯片创新联盟”，发起单位包括 Synopsys、SiFive、IAR、Tasking、SEGGER、PLS、ETAS、VECTOR、EB 等九家全球化国际企业，产业号召力获得广泛认可。

在生态合作方面，公司全资子公司天津国芯与中国移动旗下芯昇科技签署战略合作协议，共同推进量子/抗量子技术及 RISC-V 技术在物联网等领域的应用落地。在汽车电子软件生态方面，公司与经纬恒润、东软睿驰、普华软件等携手正式推出完整的 Classic Platform (CP) AUTOSAR 解决方案，加速助推“中国芯+中国软件”车用底层解决方案应用落地。

2026 年，立足江苏省 RISC-V 产业联盟理事长单位和开源 RISC-V 汽车电子芯片创新联盟牵头单位，公司将进一步加大产业链合作，积极组织产业技术研讨会，推动 RISC-V CPU、NPU 和抗量子技术在更多关键领域的应用。

二、重视知识产权，创新成果加快转化

2025 年，公司按照 2025 年度行动方案中关于知识产权工作的规划，积极鼓励员工进行技术创新和知识产权保护，在研发过程中及时将创新成果转化为知识产权。2025 年，国芯科技申请专利 117 项（其中发明专利 117 项）、软件著作权 29 项、集成电路布图 10 项、商用密码证书 5 项；授权专利 34 项（其中发明专利 34 项）、软件著作权 29 项、集成电路布图 8 项、商用密码证书 5 项。截至 2025 年 12 月 31 日，累计有效专利 185 项（其中发明专利 176 项、实用新型 6 项、外观专利 3 项）、累计有效软件著作权 237 项、有效集成电路布图 48 项、商用密码证书 43 项。

2026年，公司将全力投入新技术、新产品的研发与市场推广，确保始终紧跟市场趋势，满足消费者日益变化的需求。在这一过程中，知识产权的申报与授权仍将是公司工作的重要环节。公司将积极鼓励员工进行技术创新和知识产权保护，在研发过程中及时将创新成果转化为知识产权，以增强公司的核心竞争力。

三、加快市场推广，重视品牌建设

（一）市场推广与品牌传播

2025年，公司积极通过多种渠道展示技术实力与产品成果。全年参加了上海国际汽车工业展览会、慕尼黑上海电子展、第十二届汽车电子创新大会、SEMI-e深圳国际半导体展、世界智能网联汽车大会、汽车技术与装备发展论坛、上海法兰克福汽配展、中国国际新能源汽车技术、零部件及服务展览会、人工智能大会、天津豪密高峰论坛等二十余场业内知名展会和论坛，覆盖汽车电子、信息安全、人工智能等多个核心业务领域。同时，公司策划并完成了“走进主机厂”系列活动，先后走进奇瑞、一汽、赛力斯、理想、上汽通用五菱、东风等主机厂，与一线汽车工程师面对面交流。在媒体合作方面，公司与半导体行业观察、电子发烧友等行业媒体建立了深度合作，发布了多篇深度报道，有效传递公司价值。此外，公司新展厅的动画设计及展品陈列已全部完成，为后续客户接待和品牌展示提供了有力支撑。

2026年，公司将持续加强品牌传播工作，拟利用多种渠道和手段扩大品牌影响力。通过参与行业知名和影响广泛的展会及论坛，充分展示新产品、新技术和新应用，持续提升品牌知名度和行业影响力。在媒体传播方面，将持续加强与有影响力的行业媒体的深度合作，围绕量子安全、AI、汽车电子等核心业务方向策划专题报道，深度解读公司技术突破与市场进展。同时，持续优化公司官网、微信公众号等自有传播平台，及时发布公司动态，主动传递公司价值。

（二）客户拓展与战略合作

2025年，在汽车电子领域，公司继续推行“MCU+”策略，与比亚迪、奇瑞、吉利等头部客户的合作持续深化。在信创与信息安全领域，量子安全产品实现对中电信量子、问天量子、合肥硅臻等重要企业的批量出货。在AI MCU领域，公司基于CCR4001S和生态伙伴签署战略合作协议，加速AI芯片产品的应用落地。

2026年，公司将进一步夯实与行业头部大客户的合作基础，集中优势资源服务好关键客户，推动公司产品市场规模的增长。在汽车电子领域，继续深化与

头部车企的合作，推动高端域控 MCU 芯片、DSP 芯片、安全气囊点火芯片、线控底盘预驱芯片等产品在更多车型实现量产，以及基于 RISC-V 架构的 AI MCU CCRC4XXX 芯片上车应用。同时积极拓展国际 Tier1 标杆客户和海外市场，获得更多国际大客户定点和认可。在信创与信息安全领域，抓住抗量子密码迁移的历史性机遇，加快抗量子金融 POS 芯片、抗量子密码卡等新产品的客户导入与规模化应用，推动量子安全产品在金融、政务、能源等关键行业持续落地。在 AI 领域，依托端侧 AI 芯片 CCR4001S 的规模化应用基础，向智能家电、智能工控、智能传感等更广泛场景拓展，力争实现出货量持续增长。国芯科技将通过助力客户实现业务目标，与客户共同成长，携手开创互利共赢的新局面。

（三）品牌荣誉与产业生态建设

2025 年，公司及子公司先后荣获中国汽车芯片联盟颁发的“2025 年度创新力汽车芯片大奖”、中国汽车芯片联盟颁发的“中国汽车芯片优秀供应商奖”、中国集成电路设计创新联盟、中国汽车芯片产业创新战略联盟、上海市汽车工程学会颁发的“2025 金芯奖创新企业奖”、中国集成电路设计创新联盟颁发的“强芯 2025-中国创新 IC 产品”、工业和信息化部装备工业发展中心颁发的“‘装’点未来 2025 引领汽车技术与装备发展-智算芯片创新成果奖”、江苏省商用密码协会颁发的“2024 年度优秀密码应用方案奖-量子安全芯片及模组应用解决方案”、深圳市汽车电子行业协会颁发的“2024 年度汽车电子科学技术奖领军企业奖”、维科网颁发的“维科杯 OFweek2025 汽车行业创新产品奖”、芯师爷颁发的“2025 年度卓越成长表现企业奖”、盖世汽车颁发的“2025 第七届金辑奖最佳技术实践应用奖”、电子发烧友颁发的“2025 第六届电机控制技术市场表现奖”、苏州市领军人才联合会颁发“2025 苏州十大产业科技提名成果奖”、物联网密码应用论坛组委会颁发的“物联网密码应用创新成果”、苏州市科技局颁发的“苏州市标杆创新联合体”；中国上市公司协会颁发的“2025 年上市公司董事会办公室优秀实践”；董事会秘书学会颁发的“第二届聚董秘百佳 IRM 公司（投资者关系管理）”；财联社颁发的第六届精英董秘“最佳投资者关系团队奖”；青岛市人工智能产业协会颁发的 2025 年度“人工智能菁英企业优秀奖”等奖项；子公司天津国芯科技有限公司通过了工业和信息化部的国家级专精特新“小巨人”企业复核、天津市专精特新中小企业复评及天津创新型中小企业复核、2025 年

滨海新区领军民营企业科技创新 50 强和 2025 第十四届天津市民营经济健康发展工程“科技创新 100 强”榜单；子公司无锡国芯微科技股份有限公司和北京国芯可信技术有限公司分别通过了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局的高新技术企业认定以及北京市科学技术委员会、北京市财政局和国家税务总局北京市税务局联合组织的高新技术企业认定。

2026 年，公司将持续立足江苏省 RISC-V 产业联盟理事长单位和开源 RISC-V 汽车电子芯片创新联盟牵头单位，着眼产业生态创新发展，进一步加大产业链合作力度，适时推进 RISC-V 创新联盟相关活动。持续组织与主机厂的深度技术交流，策划“走进主机厂”系列活动，与一线汽车工程师深度互动，展示公司最新产品和解决方案。积极参与行业论坛并贡献国芯力量，通过多层次、多维度的品牌传播，进一步提高公司的行业知名度和市场美誉度。同时，积极参与产业界、资本市场各类奖项的评选，持续提升公司美誉度。

四、强化内部管理，提升经营效能

公司构建了科学、高效的管理体系，围绕现金流管理和降本增效两大核心任务，建立了基于数据驱动的“预测—执行—反馈—改进”管理机制，有效推动公司整体管理效能提升，为经营改善提供了有力支撑。

1. 现金流管理成效显著

2025 年，公司进一步加强现金流预算管理，建立月度现金流分析机制，对经营进展和现金流状况进行动态跟踪与研判，及时提出改善建议。公司建立了财务风险预警系统，对经营性现金流、自由现金流等关键指标实施实时监控与预警，推行资金计划与业务计划的穿透式管理，实现预算编制、执行监控、差异分析的闭环管控。通过上述举措，公司资金状况明显改善，为公司各项业务开展提供了坚实的资金保障。

2026 年，公司将进一步加强现金流预算管理，建立“预测—执行—反馈—改进”的闭环管控机制，对经营性现金流、自由现金流等关键指标实时监控与预警。通过强化销售合同付款条款审核、推进长账龄应收款专项催收、优化客户信用额度管理等措施，持续改善现金流状况，努力实现经营现金流为正。

2. 应收账款管理持续优化

2025 年，公司建立了跨部门联动的催收机制，针对长账龄应收款开展专项

梳理与清收工作，加大应收账款的催收力度。公司发布相关考核办法，明确回款责任，加强销售团队的激励，提高回款积极性。同时，通过强化客户信用额度管理、优化销售合同付款条件等措施，从源头控制应收账款风险，有效降低了企业交易风险。2025 年末，公司 1 年以上应收账款余额较 2024 年末下降 40.10%，长账龄应收账款结构得到显著优化。

2026 年，公司将致力于优化付款流程，缩短客户付款账期，同时积极引导客户提高预付款比例，以提高资金周转效率；进一步强化与供应商的长期战略合作，建立战略供应商分级管理制度，优化调整付款账期；加强现金的管理，提高现金利用效率。重视优化销售管理，根据市场情况与商业策略进行价格动态调整，并针对不同业务领域、不同类型客户设立合理的价格策略，扩大客户基础；定期对主要客户进行信用评估，降低企业的交易风险。

3. 采购成本管控取得实效

2025 年，公司严格执行采购审批流程，制定标准化的合同模板，强化合同审核，提升合同质量。持续开展与供应商的采购谈判，降低采购成本，优化付款账期与方式。完善供应商动态评价体系，从质量、交期、价格、服务等维度进行综合评估，确保采购渠道的稳定可靠。通过商务谈判，采购效率显著提升。公司持续深化与下游供应链的全方位战略合作，进一步加强对供应链生产流程与品质的管控以提升产品质量，同时优化生产与采购流程，并积极开拓新的优质供应商，在保障产品品质的前提下降低生产成本并保障供应链安全，提升供应链韧性和响应速度。

2026 年，公司将进一步加强执行采购审批流程。通过加强与供应商的合作与沟通，通过谈判和采购策略的优化调整，降低采购成本，提高采购效率；进一步加强供应商管理，定期进行供应商绩效评价，评估供应商的质量、交期、价格和服务水平，确保采购渠道的稳定可靠；通过采购预算和采购计划，严格控制采购成本，加强审核各环节单据，及时掌握成本变化情况。

4. 运营流程优化稳步推进

2025 年，公司上线运行差旅管理系统，实现差旅申请、审批、报销的全流程线上化管理，有效提升了费用管控效率和员工体验。同时，公司持续优化芯片设计开发、供应商管理及问题管理等核心流程。2025 年 8 月底，公司定制芯片

业务供应链恢复正常状态，第四季度该业务收入环比实现恢复，交付能力回归常态化水平。

2026年，公司将持续优化芯片设计开发、供应商管理等核心流程，不断完善运营管理体系，提升整体运营效率。

5. 质量管控体系持续完善

2025年，公司不断完善汽车电子芯片质量管理体系，系统推进 APQP 流程优化与质量文件标准化建设，并将其全面纳入 PLM 系统管理，实现所有在研项目线上化管控。通过强化内控流程、变更控制及供应商准入考核机制，持续完善质量管控体系，做到质量问题的高效解决。同时，公司搭建 ATE & Burn-in 测试平台及实验室，显著提升自主研发与测试能力。凭借全面的质量管控，公司已通过众多 Tier1 模组厂及主机厂的严格审核，获得了客户的广泛认可。

2026年，公司将持续推进提质增效工作，围绕产品设计、制造、测试、生产管理、采购管理、供应商管理及质量管理等环节，努力降低生产成本，全面推动流程标准化与高效化，通过提升产品品质、降低开发与生产成本，增强公司产品的市场竞争力。同时，优化并完善现有 IT 系统，积极引入 AI 工具，提升数字化、自动化与智能化水平，为提质增效提供有力支撑。

6. 人才团队建设持续加强

2025年，公司关键和骨干人才保持相对稳定，为各项研发和市场开拓工作提供了有力保障。公司重视员工的培训与发展，在了解员工，尤其是新员工的培训需求、职业发展目标和技能差距的基础上，有针对性地设计了丰富的专题、专业技能培训，切实提升员工技术水平。同时，加强项目考核与激励机制，对项目贡献较大的员工进行及时激励，提升员工的主动性和积极性。

2025年10月，公司实施2025年限制性股票激励计划，向176名激励对象授予922.0686万股限制性股票，明确设定了2026年实现归属于上市公司股东净利润为正的考核目标。本次激励计划将核心员工利益与公司长远发展紧密结合，进一步夯实了公司治理和人才根基。

2025年，公司以新大楼为依托，全方位加强实验室、会议室、健身房等各类工作相关场所的建设，助力员工舒心工作、健康生活。公司持续加强实验室建设，不断提升自主研发和测试验证能力，为芯片研发提供有力支撑。

2026年，公司将依托2025年实施的限制性股票激励计划，以2026年实现归属于上市公司股东净利润为正的考核目标为牵引，将目标层层分解落实，强化过程管理与结果导向，确保激励机制有效落地。在稳定人才队伍基础上，持续引进紧缺专业人才，优化人员结构；完善员工培训体系，积极推动AI工具的使用，提升工作效率；做好人力成本预算控制，将降本增效落到实处。同时，公司将继续打造积极向上的企业文化，增强员工的凝聚力和归属感。

五、压实“关键少数”责任，强化公司治理与风险管理

2025年，公司始终高度重视实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的关键作用，持续强化其履职管理和责任体系建设。公司通过组织培训、案例警示，不断提升“关键少数”的合规意识与履职能力。在机制建设方面，公司不断完善信息沟通与决策支持体系，为独立董事及各专门委员会有效履职提供必要保障；同时，持续优化高级管理人员短期与中长期相结合的激励约束机制，将绩效考评与公司战略目标、长期价值紧密衔接，推动“关键少数”勤勉尽责、主动作为，为公司高质量发展提供持续支撑，维护全体股东利益。

2025年，公司根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，进一步完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的要求，修订了《股东会议事规则》《公司章程》《董事会议事规则》等治理制度共17项。同时，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司取消设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司于2025年5月16日召开了2025年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会，依法依规完成董事会和管理层的换届工作。新一届董事会及管理层成员具备相应专业素养与履职能力，为公司后续稳健发展筑牢组织基础与人才保障。公司积极加强内审团队建设，持续完善内控体系建设，通过建立规范、有效的内部控制体系，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，从上至下强化合规教育和管理，高度重视风险防控。

2026年，公司将持续强化“关键少数”责任，依托各类培训平台，组织董事和高级管理人员参与多层次的专业培训，确保其准确掌握法律法规与监管动态，充分发挥引领作用，不断提升履职能力与经营管理水平，为公司可持续发展提供坚实保障。

2026年，公司将继续以高度的责任感和使命感，全面深入地履行作为上市公司的各项责任与义务。公司将持续建立健全完善的公司治理制度，及时按照中国证监会、上海证券交易所等的监管要求，及时修订《公司章程》和公司各项治理制度，确保决策的科学性与透明度，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展。

六、提高信息披露的质量，提升沟通效能

2025年，公司严格按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务。2025年，公司累计发布定期报告4份，临时公告81份。

2025年，公司通过上证路演中心召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会；参加了券商策略会及投资机构调研活动，接受多家机构及个人的现场或线上调研；在“苏州国芯科技”公众号上主动发布公众号文章，并通过邮箱、投资者专线电话和上证e互动平台，与投资者保持了密切沟通，为投资者答疑解惑，e互动平台回复投资者提问回复率保持100%。公司通过多种渠道及时、准确、完整地向投资者传递公司的业务模式、技术优势、研发进展、市场竞争力、发展规划等重要信息，努力保障所有投资者享有平等的知情权，深化投资者对公司发展理念的理解和认同。

2026年，公司将始终坚持诚实守信、合规经营的理念，严格按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务，将信息披露工作落到实处和细节上，努力提高信息披露质量，致力于保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。同时，公司将借助股东会、业绩说明会、投资者交流会、官方网站、社交媒体、券商策略会、投资者调研沟通会等多个渠道，构建更加透明、高效的信息披露机制，与投资者继续保持密切沟通。公司将通过多种渠道及时、准确、完整地向投资者传递公司的业务模式、技术优势、市场竞争力、发展规划等重要信息，努力保障所有投资者享有平等的知情权，深化投资者对公司发展理念的理解和认同。

七、重视投资者回报，努力提升公司经营质量

2025年，公司持续重视投资者回报。公司于2024年4月启动的第二期股份回购方案，截至2025年4月17日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,150,747股，占公司总股本的比例为0.64%，回购成交的最高价为26.16元/股，最低价为14.63元/股，支付的资金总额为人民币39,104,491.80元（含印花税、交易佣金等交易费用），第二期回购方案实施完毕。

2026年，公司将依托2025年实施的限制性股票激励计划，将核心员工利益与公司长远发展紧密结合，以“全力实现扭亏为盈”为考核目标，推动公司经营质量持续提升。公司将通过优化业务布局、加强技术研发、拓展市场份额等方式，努力提升盈利能力和核心竞争力，不断改善公司的经营质量，力争以更好的公司经营业绩回报广大投资者，实现公司价值与股东利益的共同增长。

公司将抢抓“十五五”开局的战略机遇期，以只争朝夕的干劲抢抓机遇，以钉钉子的精神狠抓落实，切实推动公司高质量发展，为股东创造更大价值，努力成为我国领先的具有可持续发展能力的自主嵌入式CPU设计企业，从而更好地回报广大投资者。

本行动方案基于公司当前实际情况及行业发展趋势制定，未来可能受到政策调整、市场环境变化等因素影响，相关规划与战略属于前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日